

※課題番号 : F-12-FA-0041
※支援課題名 (日本語) : LED 評価基板へのワイヤーボンディング
※Program Title (in English) : Assembly of LED Device
※利用者名 (日本語) : 外村 翼, 猿渡 洋孝, 宮田 彩子
※Username (in English) : Tsubasa TOMURA, Hirotaka SAWATARI, Ayako MIYATA
※所属名 (日本語) : 三菱化学株式会社
※Affiliation (in English) : Mitsubishi Chemical Holdings

※概要 (Summary) :

LED チップを LED パッケージへと実装し、点灯
LED サンプルの作成を行った。

※その他・特記事項 (Others) :

特になし

※実験 (Experimental) :

実装には下記装置を使用し評価を行った。

- ・エポキシダイボンダー : WEST・BOND 7200CR
- ・ワイヤーボンダー : WEST・BOND 747677E

共同研究者等 (Coauthor) :

なし

論文・学会発表 (Publication/Presentation) :

なし

※結果と考察 (Results and Discussion) :

- ・ダイボンは問題なし。
- ・ワイボンは Au 線 25um Φ を使用して
1st のボール径および US Power の条件出しを
行い良好な 1st ボールが得られた。

関連特許 (Patent) :

なし

